

Agナノペースト

Ag Nano Paste

鉛フリー高温はんだ代替に最適

Ideal as a lead-free high-temperature solder alternative

特長

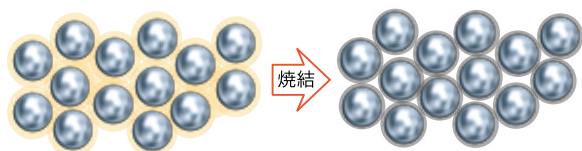
- 250°Cで焼結/接合、Agの融点960°Cまで再溶融しない
- オーミックなコンタクトを有し、銀と同様な抵抗値を示す
- 印刷用、ディスペンス用での供給が可能



仕様

- 250°Cで焼結/接合、Agの融点960°Cまで再溶融しない

動作温度が高いパワーモジュールやLED実装に最適

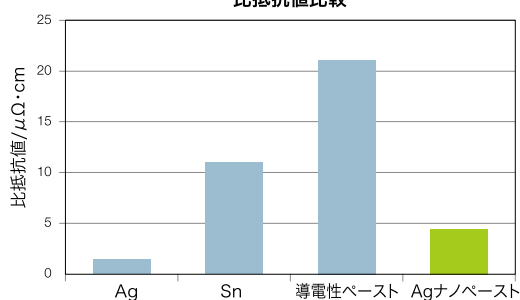


有機分子で保護し、常温での焼結を防止
250°Cで保護層分解

近傍粒子同士が表面積を下げ、結合(ネッキング)する。

- オーミックなコンタクトを有し、銀と同様な抵抗値を示す

比抵抗値比較



- 性能一覧表

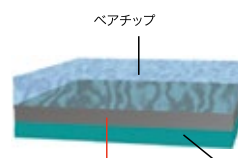
項目		性能	試験方法
粉末	1	金属	銀ナノ粒子
	2	焼結温度	200~300°C
	3	形状	薄片状
	4	粒径	<300nm
ペースト	5	粘度	30~100 Pa·s
	6	比抵抗値	<10μΩ・cm
	7	絶縁抵抗	1×10 ¹⁰ Ω以上
	8	マイグレーション (85°C, 85%RH)	発生せず (1000h)
	9	フラックス含有量	10~12%
	10	粘着力	1.0N

- 960°Cまで再溶融しない特徴を生かして各種用途に応用

動作温度の高いLEDに

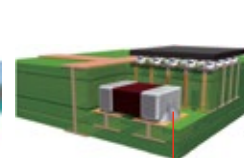


デバイスの
ダイボンディングに



Agナノペースト

3D実装の
内部接続用として



Agナノペースト

- 焼結状態



- Agナノ焼結体接合写真

